

株式会社 トリケミカル研究所  
第46期(2024年1月期)  
決算説明資料

東京証券取引所  
証券コード:4369

# 1. 2024年1月期業績

単位：百万円

	(ご参考) 23.1期	24.1期	増減額	増減率
売上高	13,803	11,246	-2,557	-18.5%
営業利益	3,504	1,947	-1,556	-44.4%
経常利益	6,186	3,276	-2,909	-47.0%
当期純利益	4,832	2,470	-2,361	-48.9%

主にメモリ不況の影響を受け売上・利益とも前期比大幅減  
経常利益に持分法投資利益1,036百万円

単位：百万円

	24.1期末	(ご参考) 23.1期末	増減額
流動資産	19,008	18,922	86
固定資産	12,856	13,192	-336
資産合計	31,864	32,115	-250
流動負債	2,553	3,675	-1,121
固定負債	1,740	2,563	-823
負債合計	4,294	6,239	-1,944
株主資本	26,761	25,265	1,495
その他包括利益累計額	808	610	198
純資産合計	27,570	25,876	1,694
負債純資産合計	31,864	32,115	-250

## 主な増減要因

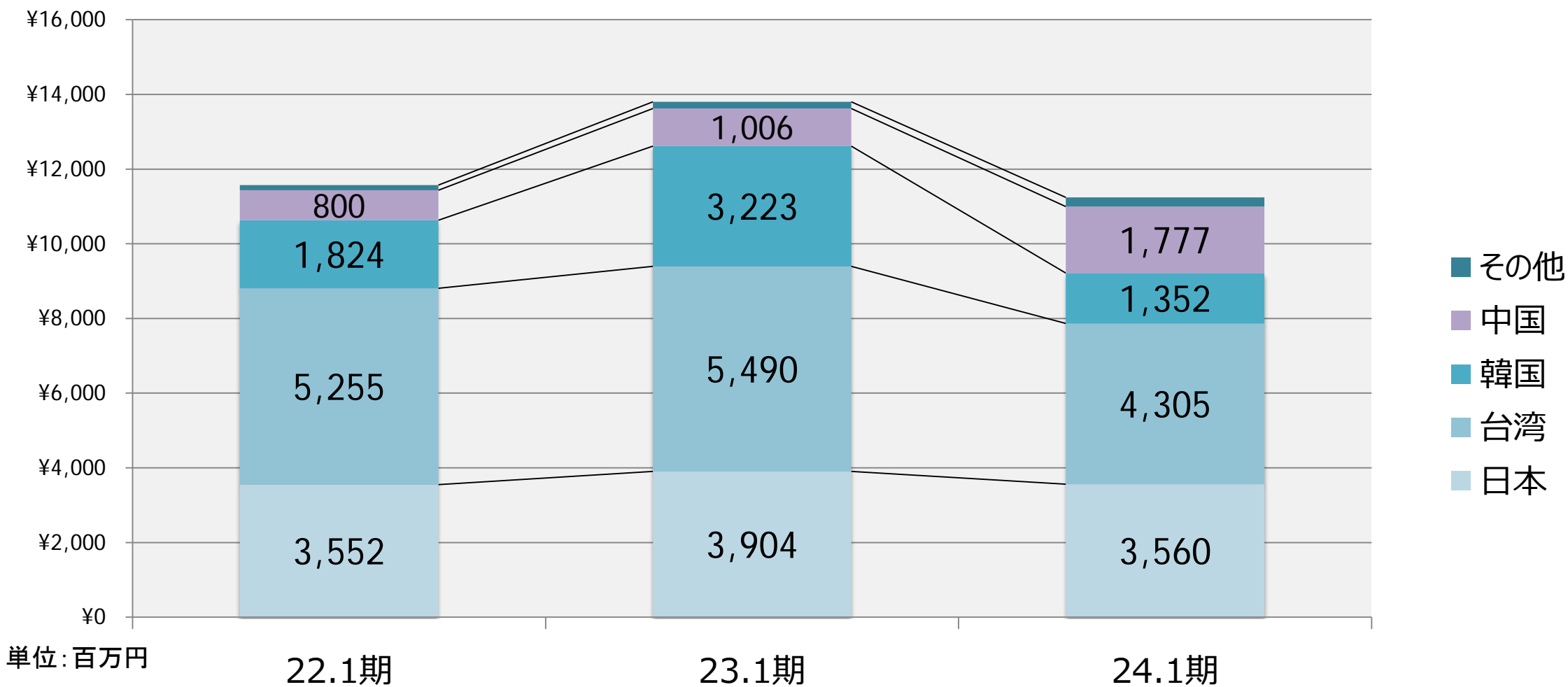
流動資産	棚卸資産の増加	+1,282
	現金及び預金の減少	-640
	売掛債権の減少	-526
固定資産	持分法適用会社からの配当等に伴う 投資有価証券減少	-1,422
	設備投資に伴う有形固定資産の増加	+896
流動負債	買掛金の減少	-787
	未払法人税等の減少	-551
固定負債	長期借入金の減少	-700
純資産	純利益計上による利益剰余金の増加	+1,495

単位:百万円

	24.1期
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,858
現金及び現金同等物の増減額	-640
現金及び現金同等物の期末残高	10,497

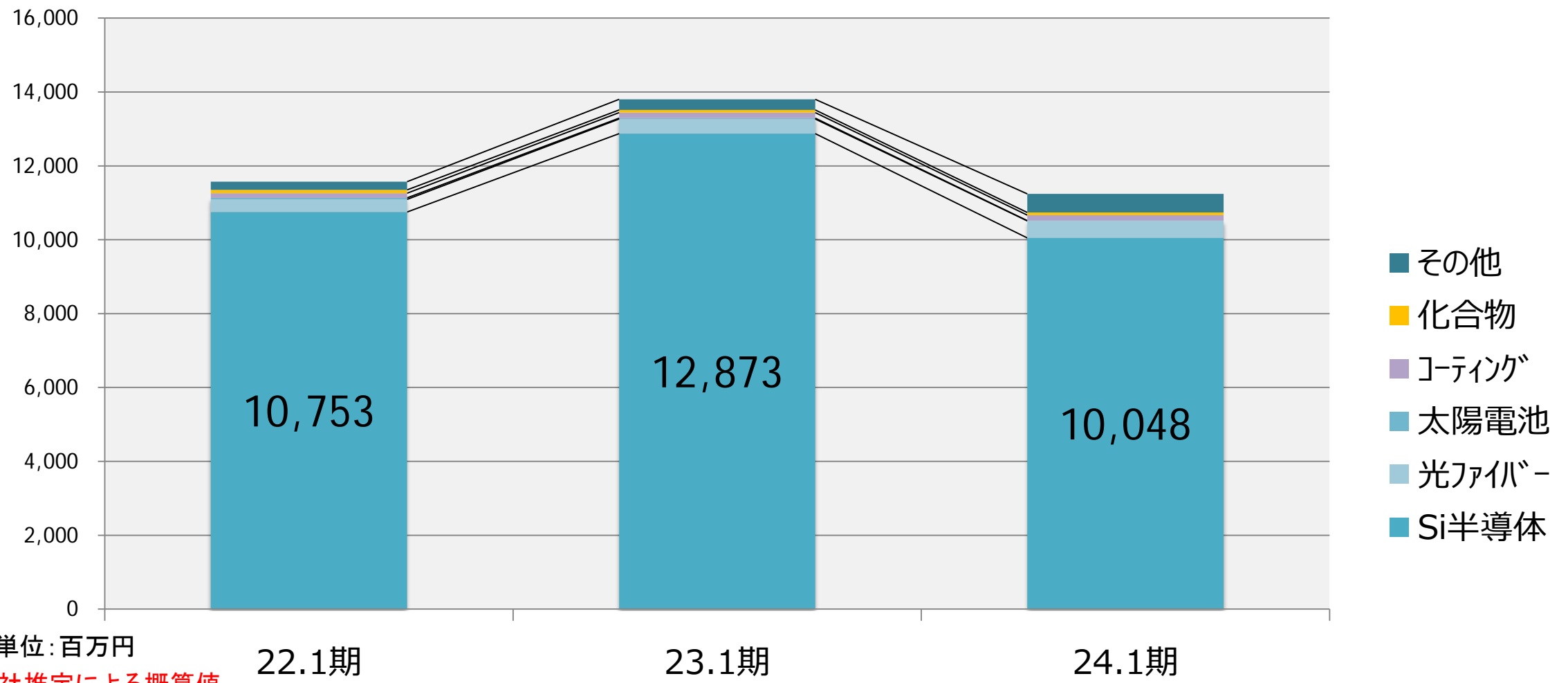
## CFの状況

営業CF	税前当期利益計上	+3,276
	利息・配当金の受取額	+2,542
	法人税等の支払額	-1,520
	棚卸資産の増加額	-1,260
投資CF	有形固定資産の取得	-1,739
財務CF	配当金の支払額	-973
	借入金の返済	-785



※当社推定による概算値

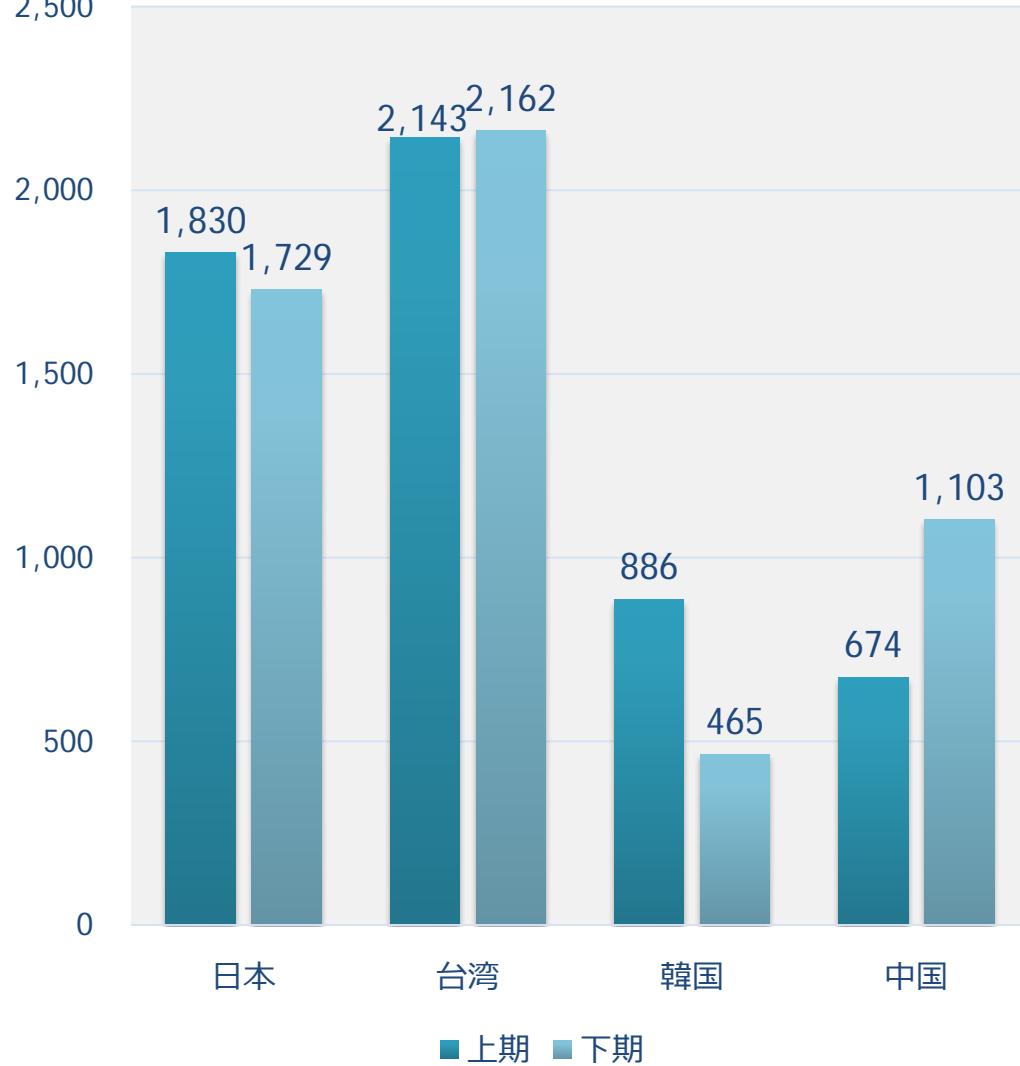
中国向けは大幅増も他は減少



半導体向け売上が大幅に減少

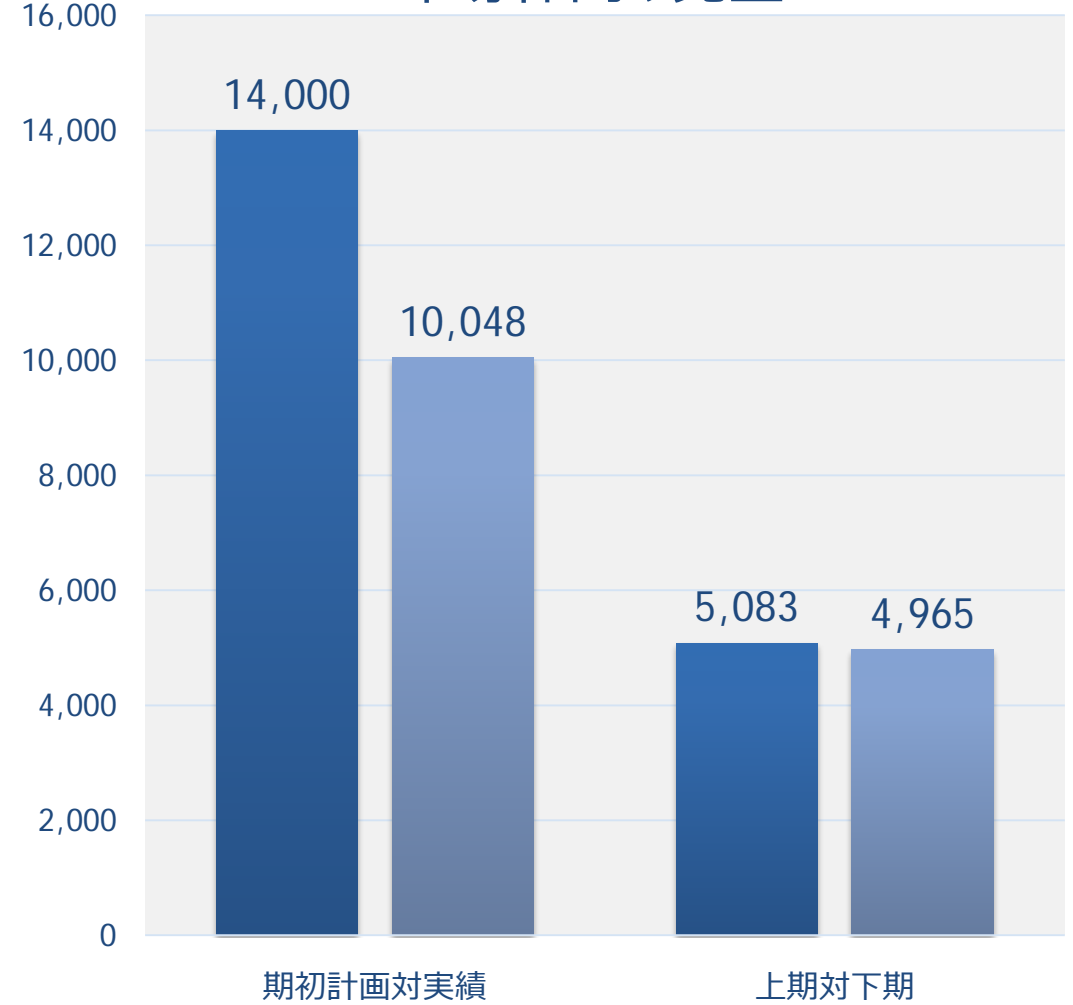
単位:百万円  
2,500

### 地域別売上

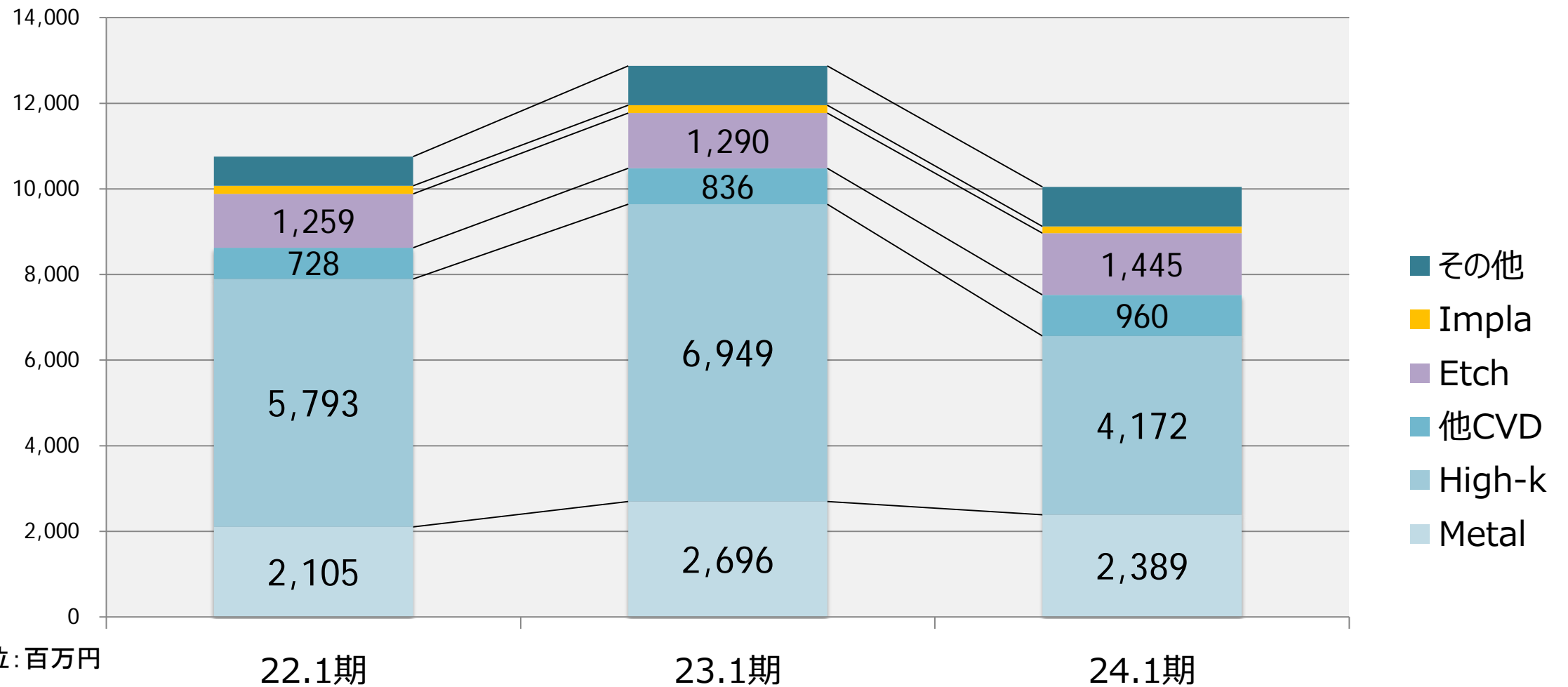


単位:百万円

### Si半導体向け売上

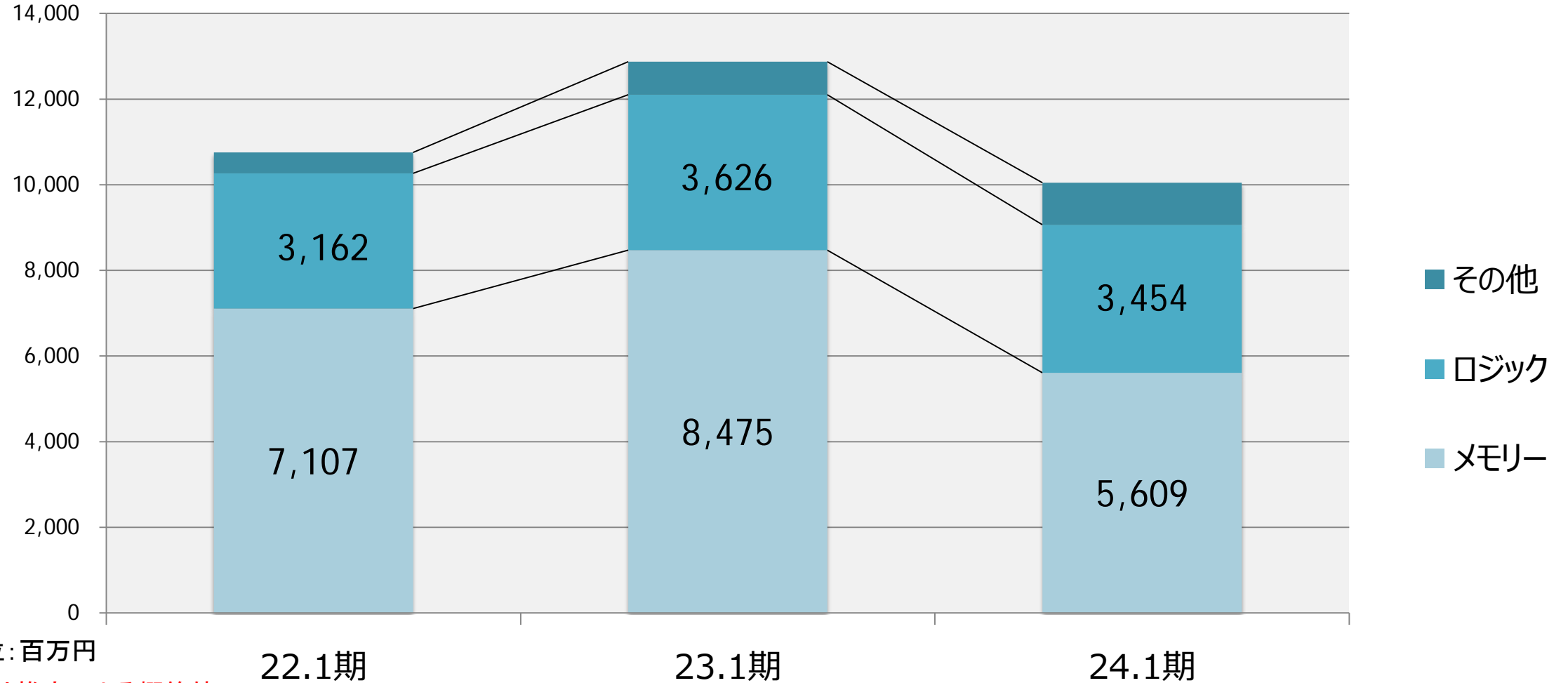




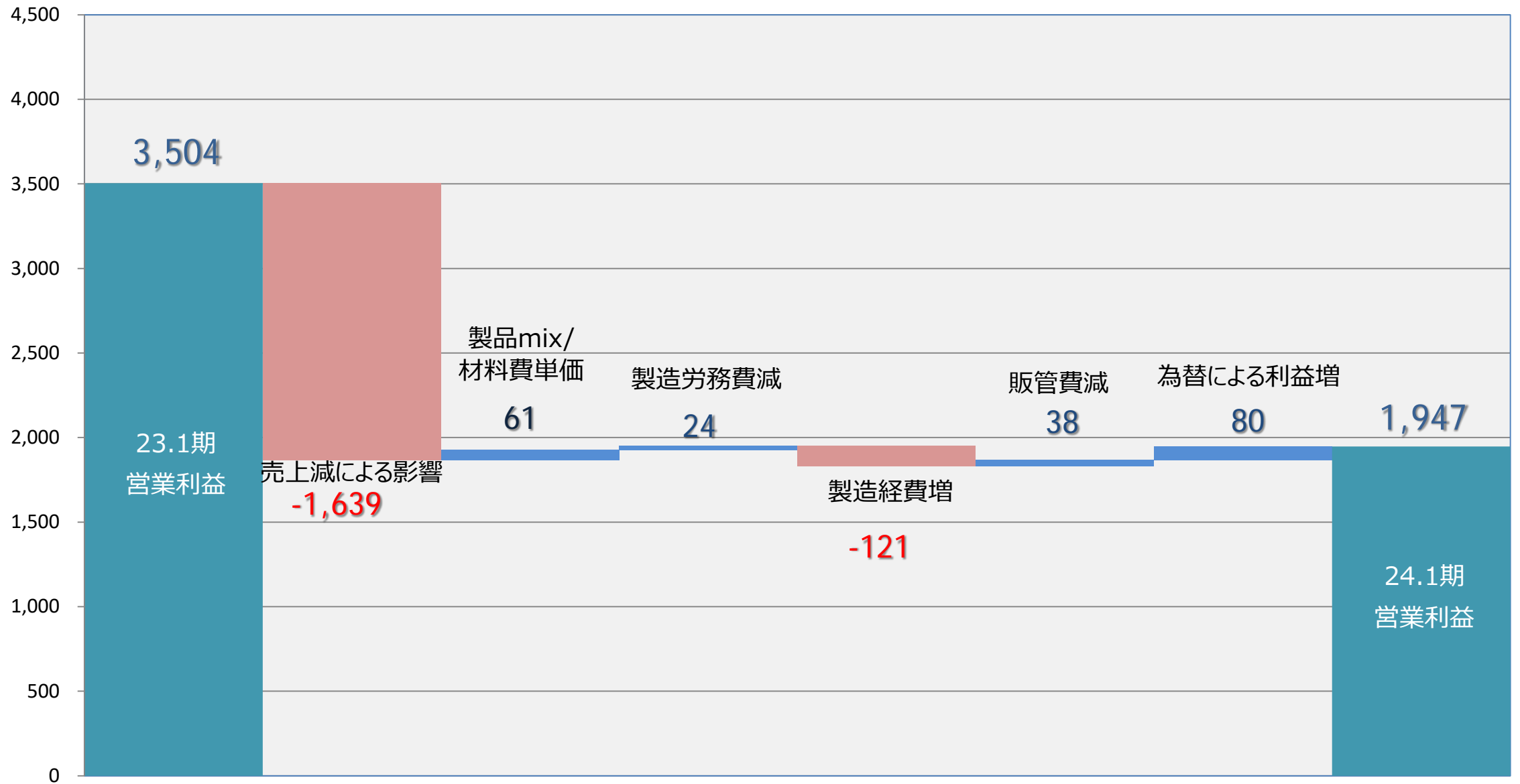


※当社推定による概算値

DRAM向けHigh- k 材料が大幅減



メモリー向け材料の落ち込みが顕著



※研究開発費振替前

単位:百万円

## 2. 2025年1月期業績計画

単位：百万円

	24.1期実績	25.1期計画	(ご参考) 増減率
売上高	11,246	14,890	32.4%
営業利益	1,947	3,380	73.5%
経常利益	3,276	4,880	48.9%
当期純利益	2,470	3,730	51.0%

為替は140円/米ドルに設定 (25.1期営業利益感応度は1円≒30百万円)

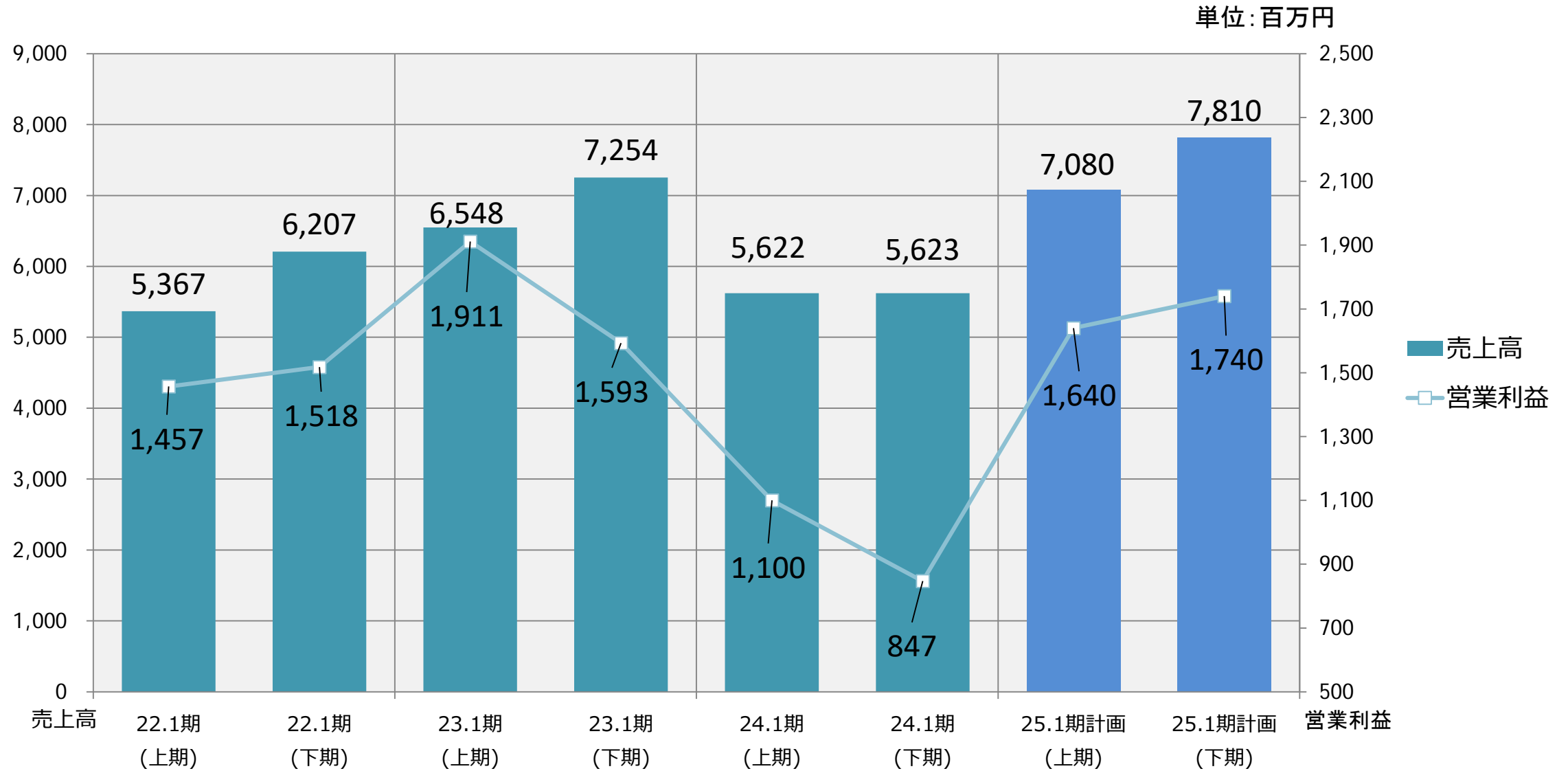
- ・持分法投資利益10.3億→15.3億
- ・24.1期に計上の為替差益等3億強が前期比減少

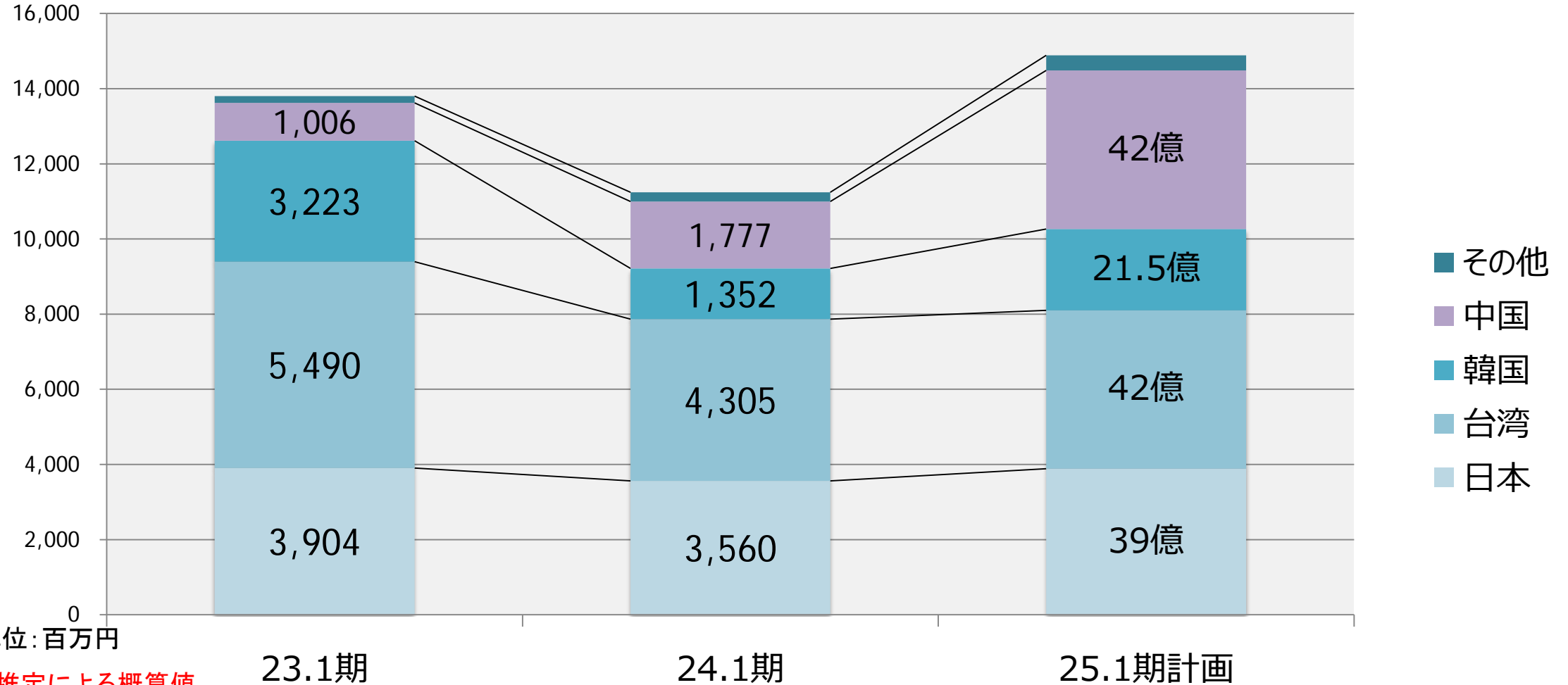
## 外部環境

- メモリー半導体の稼働は後半にかけて徐々に回復
- ロジック半導体向けは概ね好調に推移
- 原材料費、経費等は引き続き上昇もしくは高止まり傾向
- 中国向け売上が大幅増の見込み

## 今期の取り組み

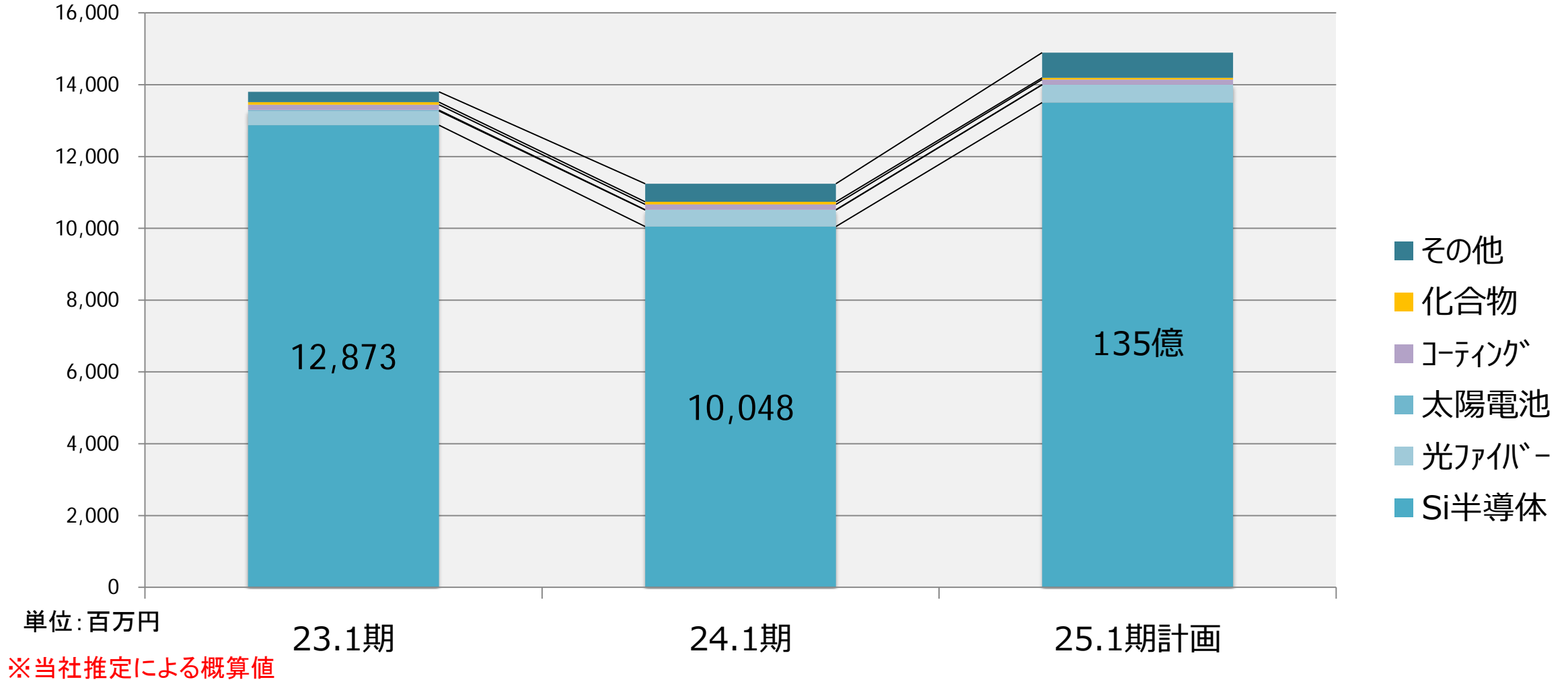
- 南アルプス事業所建設工事の円滑化
- 半導体・製造装置メーカー等と連携した次世代半導体向け材料の開発
- 生産の効率化、安全・品質管理の強化
- 台湾子会社の出荷増に向けた活動の継続



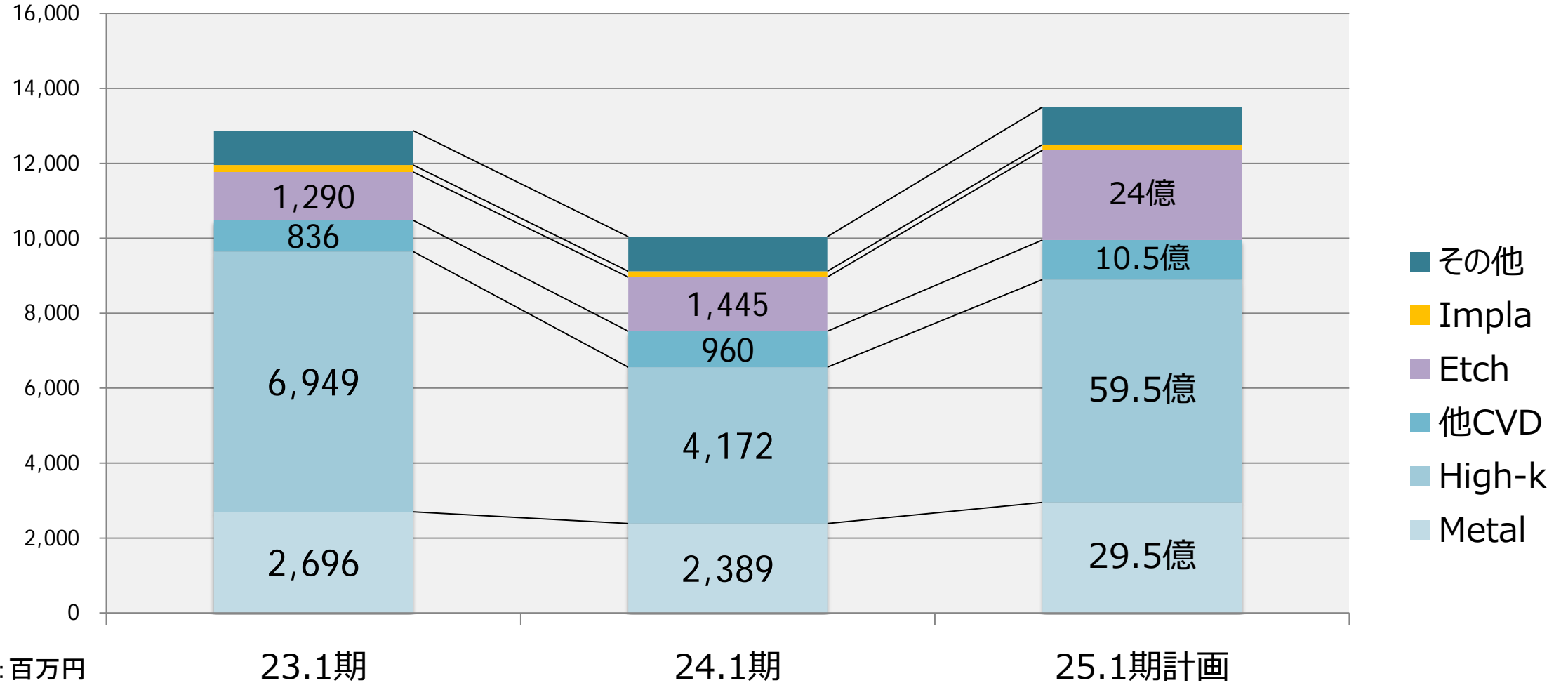


中国向け売上が大幅増



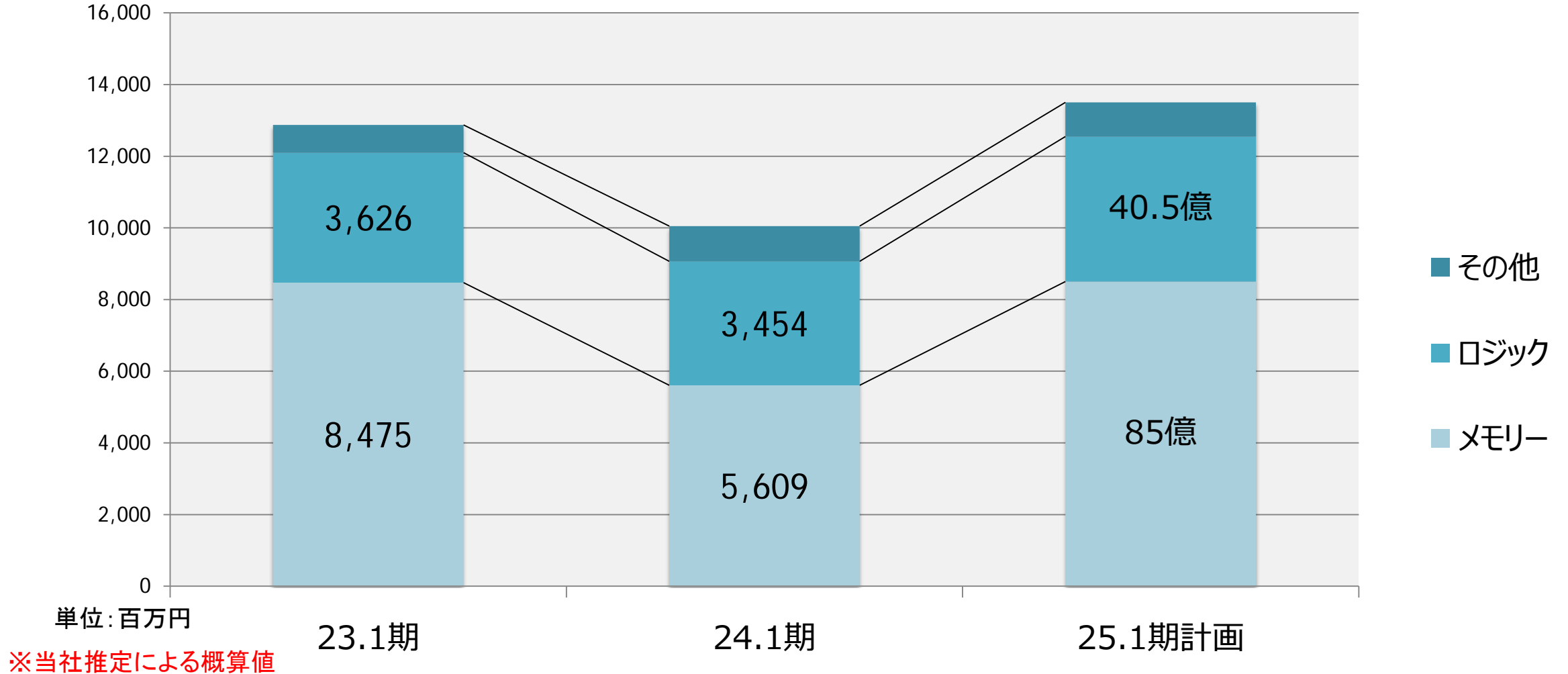


半導体向け材料は後半を中心に持ち直し

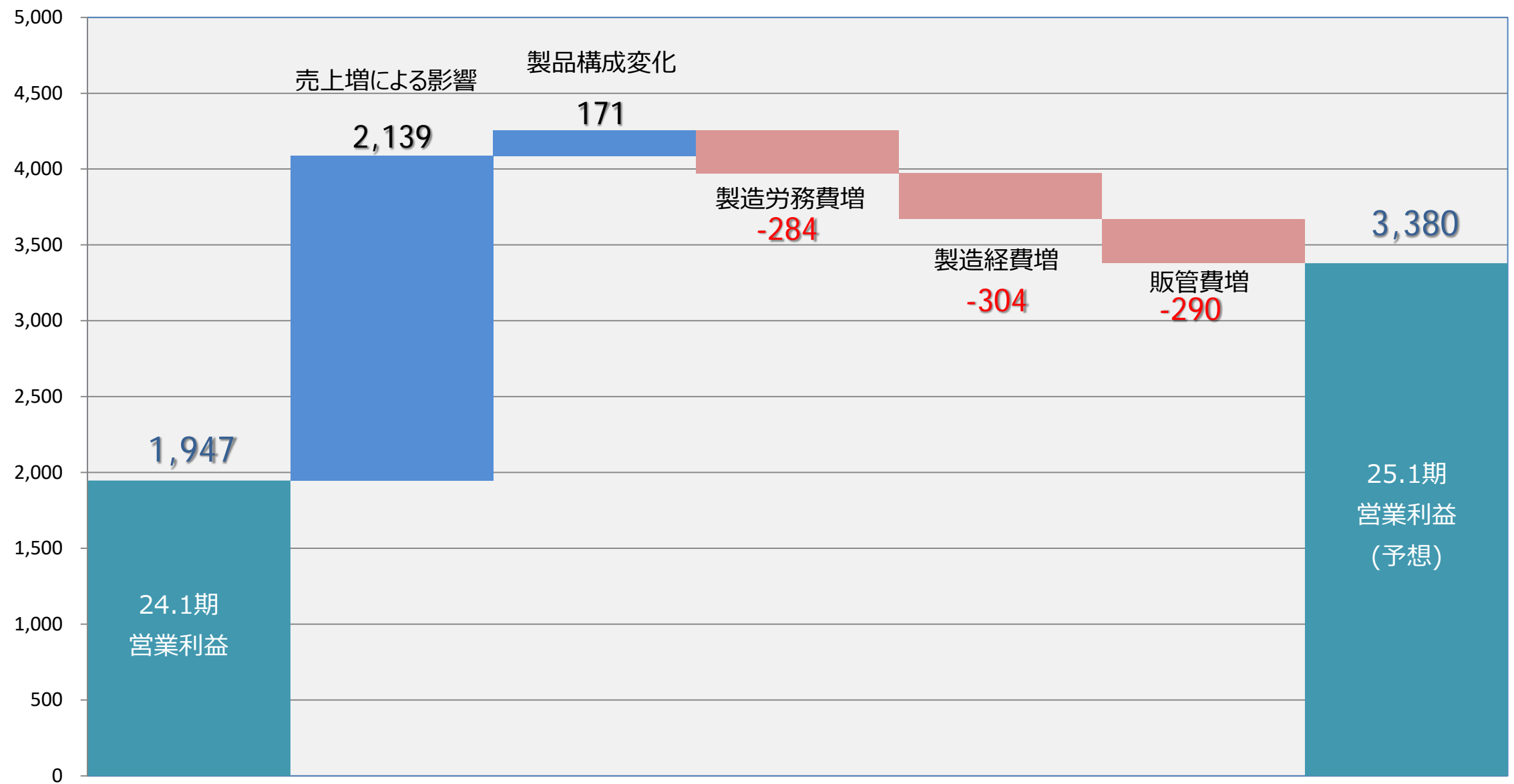


単位:百万円  
 ※当社推定による概算値

エッチング材料・CVD系材料が堅調



メモリー向け・ロジック向けともに回復



※研究開発費振替前

単位: 百万円

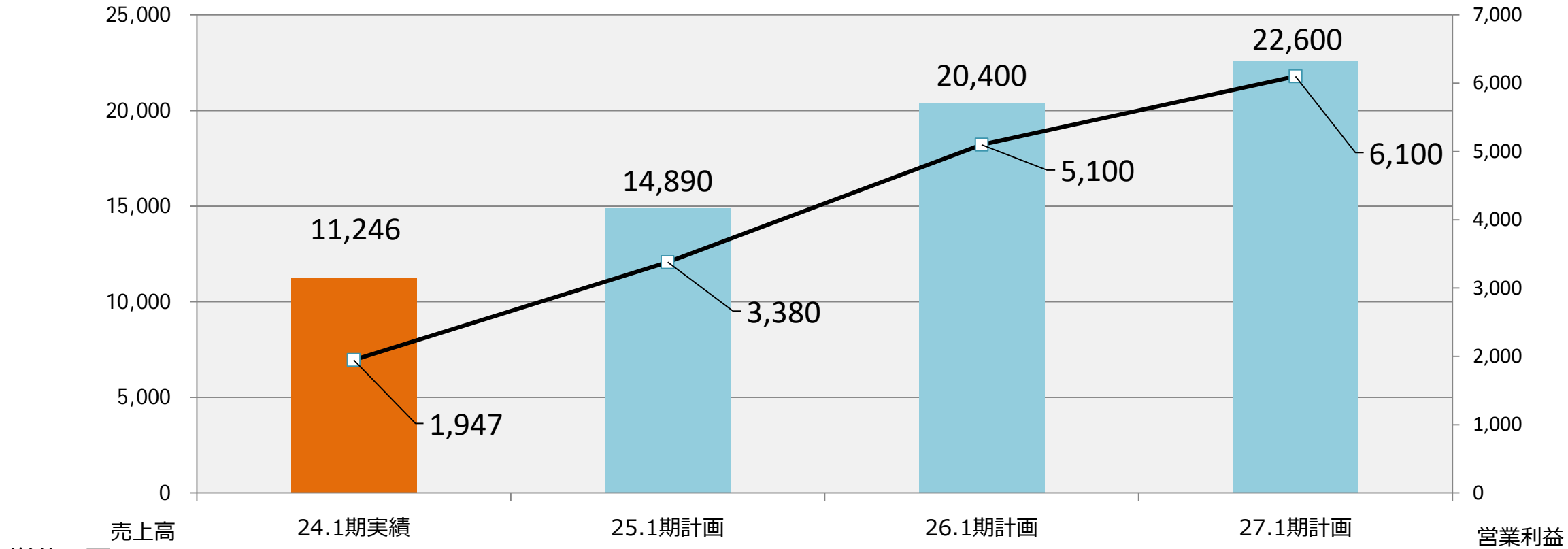
### 3. 中期経営計画

## 中期経営計画の前提

1. 半導体業界は徐々に回復、成長路線に
2. 為替は1米ドル = 140円に設定
3. 現時点で予測される購入・販売価格の変動は織り込み済み
4. 26.1期に南アルプス事業所竣工・稼働開始
5. 設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円)

	25.1期	26.1期	27.1期	3期合計
投資総額	3,343	6,607	3,520	13,470
償却費総額	1,375	1,841	2,275	—

6. 増員計画      15~20名程度/毎期の増員
7. 持分法損益      3年ともに1,530百万円/年を持分法利益として見込む



	24.1期実績	25.1期計画	26.1期計画	27.1期計画
売上高	11,246	14,890	20,400	22,600
営業利益	1,947	3,380	5,100	6,100
経常利益	3,276	4,880	6,600	7,600
当期純利益	2,470	3,730	4,940	5,600

	24.1期実績	25.1期計画	26.1期計画	27.1期計画
売上高	11,246	14,890	20,400	22,600
営業利益	1,947	3,380	5,100	6,100
売上高増加額	—	3,643	5,510	2,200
売上高 営業利益率	17.3%	22.7%	25.0%	27.0%

単位：百万円

営業利益率25%程度の維持を目標



## 外部環境

- 半導体業界は徐々に回復・再度成長へ
- 半導体微細化・高性能化により新規プロセス・材料の導入  
→次世代半導体に向けた新材料ニーズ・高性能化の需要は継続

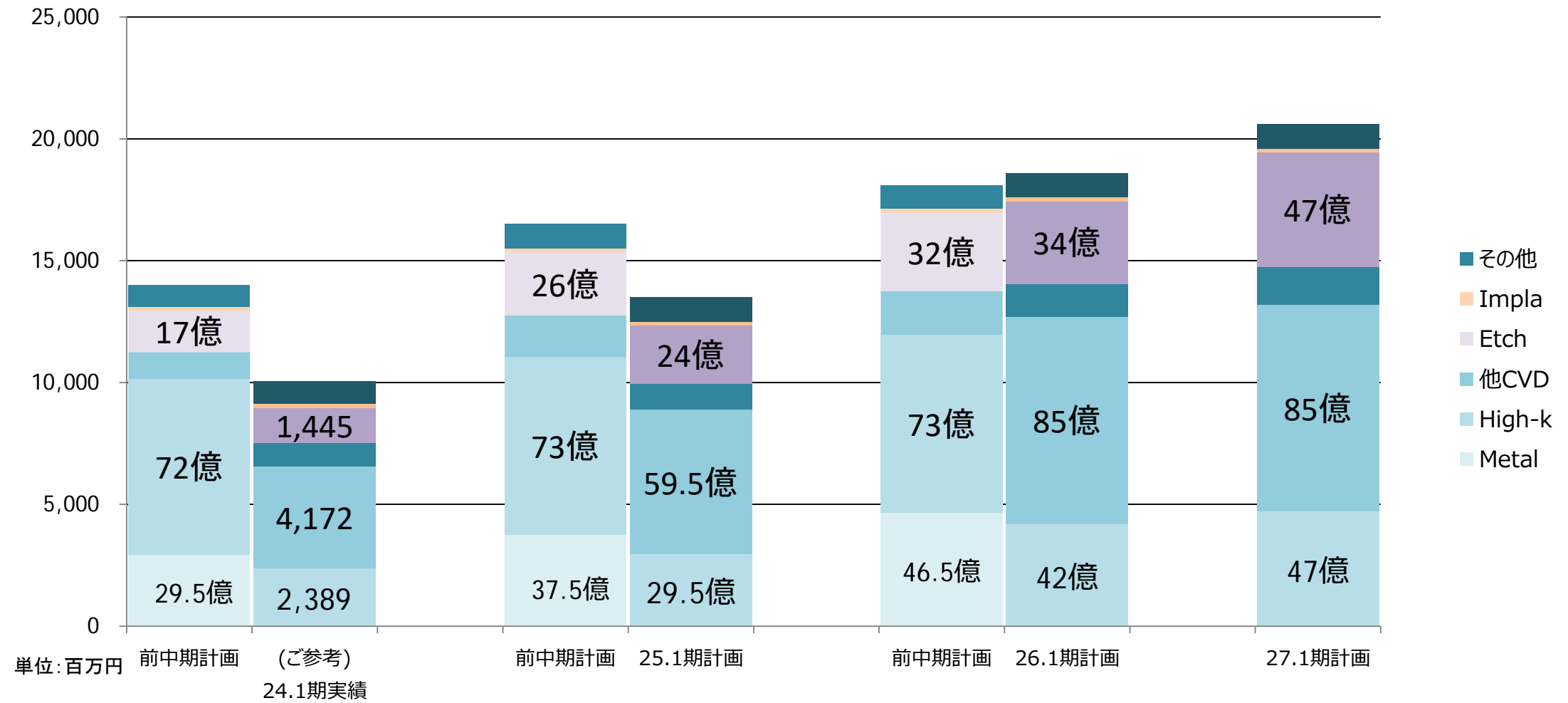
## 当社の取り組み

- グループにおける生産・開発能力向上を継続  
次世代新規材料を中心とした量産体制構築・自動化(新工場建設)  
台湾子会社工場の生産能力・韓国関係会社との連携強化  
安全・品質・コスト管理体制の向上  
拠点の増加に伴う事業継続計画の改善・サステナビリティ活動の追求



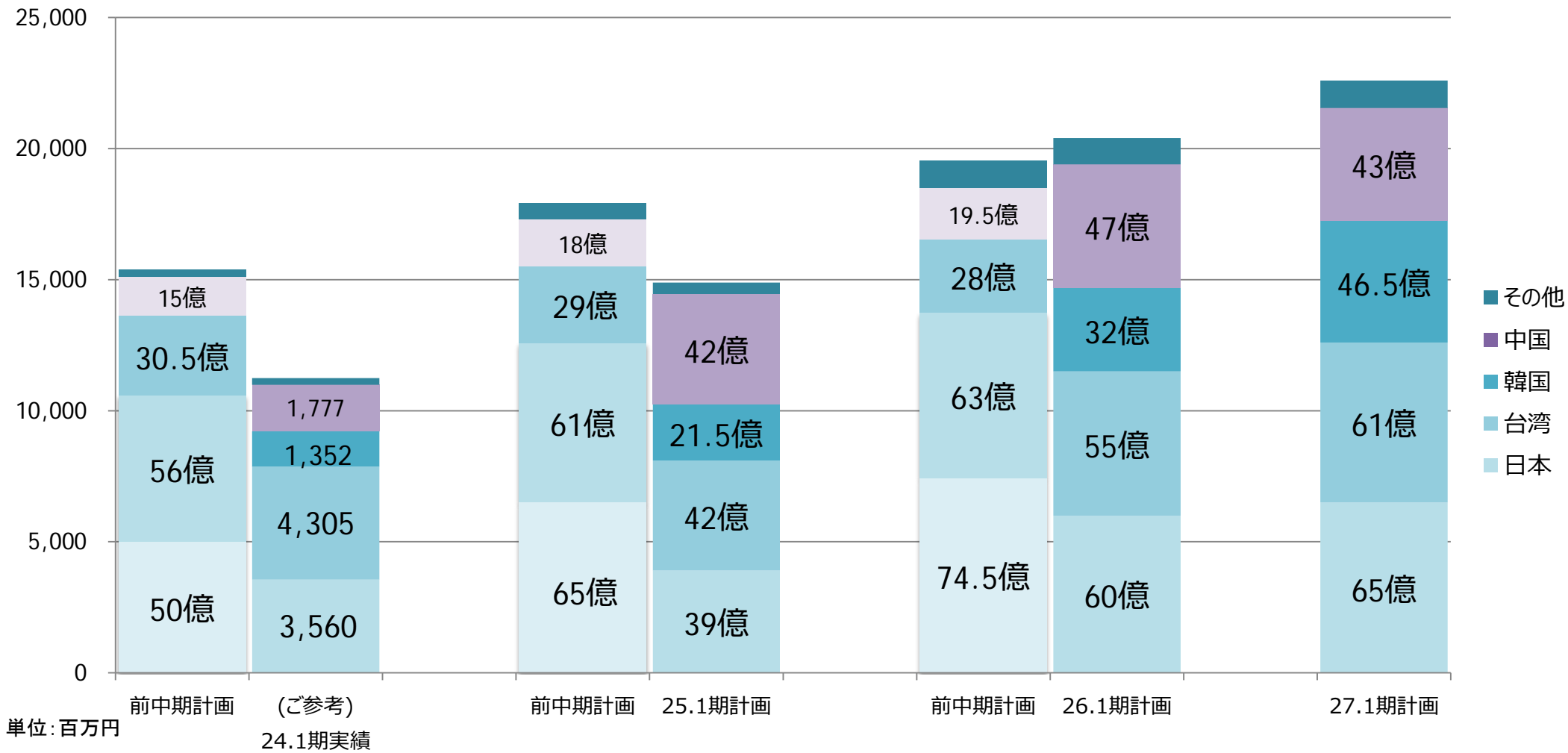
26.1期前半に竣工・稼働予定、次世代3D NAND用エッチング材料等を生産  
今後成長の見込まれる新規素材の開発・量産拠点としても活用  
投資額は約90億円(27.1期まで)

中期販売計画(Si半導体)※前中期計画との比較含む



High-k・メタル材料の回復+エッチング材料の成長

中期販売計画(地域別)※前中期計画との比較含む



東アジア各国での売上高が拮抗

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。

あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先 : [homepageinfo2@trichemical.com](mailto:homepageinfo2@trichemical.com)